



平成 29 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 T O W A 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 田 博 和
(コード番号 6315 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長
蒲 生 喜 代 重
TEL (075) 692 - 0251

コンプレッション装置の納期 1 ヶ月対応開始について

当社は創業以来、半導体樹脂封止プロセスにおいてデファクトスタンダード（業界標準）を数々生み出し、リーディングカンパニーとして業界を先導して参りました。

近年、半導体は高集積化・高機能化が進んでおり、その製造装置に要求される市場のレベルも益々高まっております。また、急速な生産立上げや新製品における市場投入のタイミングを柔軟に対応したいというお客様の要望も強くなってきております。

このような状況のもと、当社は独自技術を用いたコンプレッション装置を開発し、品質要求や納期に応じて参りました。

今回、更なるお客様の納期短縮の要望に応えるべく、当社は既存製造プロセスのスループット向上のため、コンカレントエンジニアリング※手法を取り入れることにより、下記のコンプレッション装置について納期を従来の 3 ヶ月から 1 ヶ月に短縮することに成功しました。

これは、豊富なデータベースを持ち、業界に精通した当社だからこそ出来たことであり、更に対象機種を広げていく予定であります。

半導体は IoT（モノのインターネット）やデータセンターの増設等の流れを受け、今後も需要の伸びが予測されており、当社もこの短納期対応を強みの一つとして更にビジネスの機会を広げて参りたいと考えております。

※ 製品の製造プロセスを構成する複数の工程を同時並行で進め、各部門間での情報共有や共同作業並びに部品の標準化を行うことで、製造期間の短縮を図る手法。

記

1. 対 象 製 品 名 : P M C 1 0 4 0 - D
2. 納 期 : 受注から出荷まで 1 ヶ月
3. 受注開始時期 : 2017 年 4 月より
4. 生 産 台 数 : 月産 5 台（順次拡大予定）

以 上